

第 145 回ラドテック研究会講演会

主催：一般社団法人ラドテック研究会

期 日：2016年1月26日（火）13：00～17：00

場 所：東京理科大学神楽坂キャンパス1号館17階／記念講堂
東京都新宿区神楽坂1-3

<講師と演題>

1) 13：00～13：50
「紫外線硬化接着剤の硬化収縮と残留応力」
東京工業大学 佐藤 千明 氏

2) 13：50～14：40
「高感度光重合開始剤の開発」
株式会社 ADEKA 滋野 浩一 氏

14：40 ～ 15：00 ♪♪♪♪♪ コーヒーブレイク ♪♪♪♪♪

3) 15：00～15：50
「UV 硬化を利用した下水管更生技術」
光硬化工法協会 大河原 隆 氏

4) 15：50～16：40
「IR+UV ハイブリッド照射システム」
へレウス株式会社 河村 紀代子 氏

◆17：00～18：30 交流会 大会議室にて 会費 1,000円

1. 参加費 個人会員（本人）無料
 法人会員（2名まで）無料 3名から1名10,000円
 非会員は1名20,000円
 協賛団体に所属されている方は下記の通りとなります。
- 協賛団体所属の方：10,000円
 注・上記参加費には、講演要旨集1冊を含みます。
2. 申込締切日 2016年1月8日（金）
3. 申込方法 添付申込書に必要事項をご記入後E-mailにてお申し込み下さい。
4. 入金方法 参加費は銀行振込にてお願い致します。
 （尚、振込手数料はご負担下さい。）
 振込先：みずほ銀行 麹町支店（銀行コード：0001 店番号：021）
 口座番号：普通預金）1361387
 口座名義：一般社団法人ラドテック研究会
 名義カナ：シャ）ラドテックケンキュウカイ
 ご入金は開催日までにお願ひ申しあげます。
- ※一度ご入金された参加費は返金致しかねますので、あらかじめご了承ください。
5. 参加証 ご入金確認後参加者本人宛お送り致します。
 従ってお申し込み及びご送金が申込締切日以降で開催日が迫っている
 場合は参加証が届かない場合がありますので、参加受付番号等を事務局
 まで事前にお問い合わせ下さい。なお、領収書は振込受領書をもって
 かえさせていただきます。
6. 問合せ先 一般社団法人ラドテック研究会事務局
 〒102-0082 千代田区一番町23-2 番町ロイヤルコート207
 TEL：03-6261-2750 FAX：03-6261-2751
 E-mail：staff@radtechjapan.org

受講申込書
<協賛団体所属の方>

<一般社団法人ラドテック研究会事務局宛>

E-mail: staff@radtechjapan.org

FAX: 03-6261-2751

第 145 回講演会に受講申込み致します

所属先:

(会社名/大学名等)

氏 名:

住 所: 〒 _____

T E L : _____ F A X : _____

E-mail : _____ @ _____

★請求書は ・ 必要です ・ 必要ありません (どちらかに○)

☆受講料は _____ 月 _____ 日
・ 振り込みました ・ する予定です (どちらかに○)

★協賛団体名: _____ (ご記入ください)

振 込 先: みずほ銀行 麹町支店 (銀行コード: 0001 店番号: 021)

口座番号: 普通預金) 1361387

口座名義: 一般社団法人ラドテック研究会

名義カナ: シャ) ラドテックケンキュウカイ

(尚、振込手数料はご負担頂きたくお願い申し上げます。)